

証券コード：2760



野村IR資産運用フェア2019

2019年12月20日（金）

東京エレクトロン デバイス株式会社
代表取締役社長 徳重 敦之

本日の目次

- 会社概要
- 当社のビジネスモデルと特長
- 将来の成長に向けた取り組み
- 今期業績見通し 配当政策 株価



会社概要

会社概要



設立年月日

1986年3月3日

本社所在地

神奈川県横浜市神奈川区金港町1-4 横浜イーストスクエア

資本金

24億9千5百万円

売上高

1,410億円（2019年3月期）

従業員数

連結 1,229名（2019年9月30日現在）

主な事業内容

1．半導体及び電子デバイス（EC）事業

半導体、ボード、ソフトウェア、電子部品の販売、設計・開発

2．コンピュータシステム関連（CN）事業

ネットワーク、ストレージ、ソフトウェアの販売、保守サービス

拠点・グループ

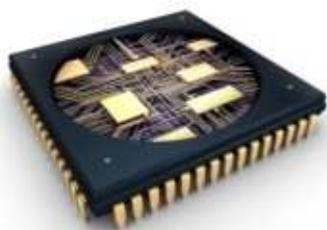
国内 18拠点、子会社 7社、関連会社 3社



事業内容



最先端の半導体やITシステムなどを提供する専門商社
メーカー機能の強化に注力



半導体



基板（ボード）



設計・量産受託サービス



ITインフラ機器



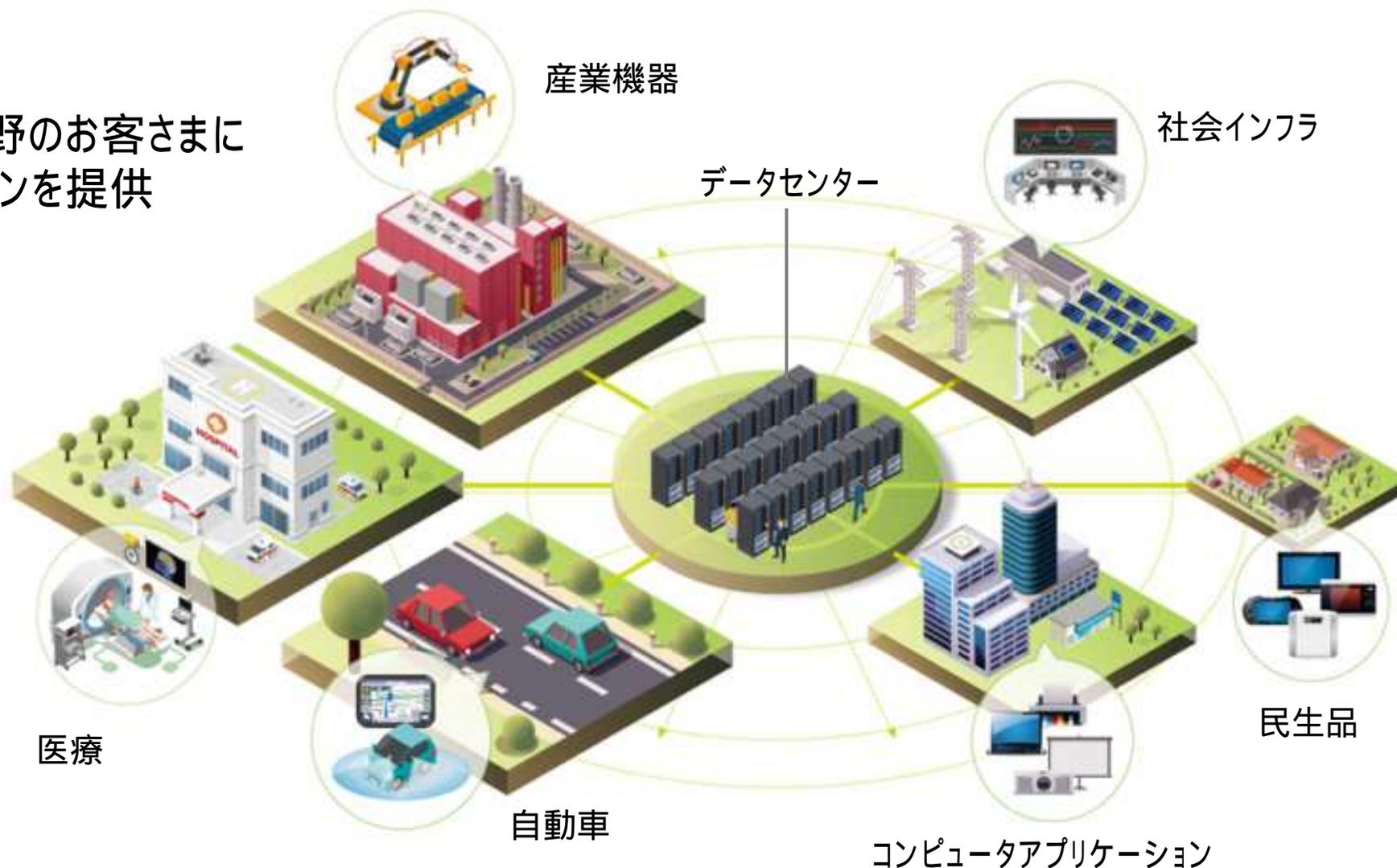
セキュリティソフトウェア



IT保守・運用サービス

当社の製品が使用される分野

幅広い分野のお客さまに
ソリューションを提供





半導体/フラットパネルディスプレイ
製造装置メーカー

東京エレクトロン

半導体製造装置事業



フラットパネルディスプレイ
製造装置事業

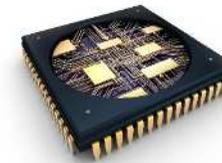


専門商社

東京エレクトロデバイス

半導体及び電子デバイス
(EC) 事業

コンピュータシステム関連
(CN) 事業



- EC事業とCN事業が分離・独立
- 東京エレクトロンの出資比率は33.82%
- 東京エレクトロンの持分法適用関連会社



当社のビジネスモデルと特長

ビジネスモデル

仕入先

東京エレクトロデバイス (TED)

販売先

海外有力メーカーの
半導体・電子部品



**半導体及び電子デバイス
(EC) 事業**

半導体等の提案、販売、技術サポート

自社ブランド(PB)事業

設計・量産受託サービス
自社ブランド製品の開発、製造、販売

**コンピュータシステム関連
(CN) 事業**

IT製品の提案、販売、保守サポート



電子機器・産業機器などの
製造業 (メーカー) が中心

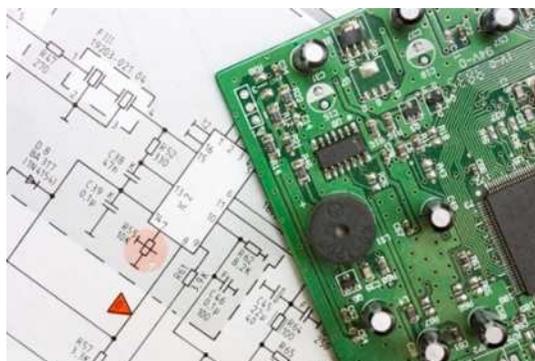
システム会社
官公庁
一般企業

メーカー機能（PB事業）による開発力

基板の設計から製造までをワンストップで提供する設計・量産受託サービス

設計・量産受託サービス

設計



開発



量産



東京エレクトロン デバイス長崎株式会社
(TED長崎)

メーカー機能（PB事業）による開発力

製造業における生産ラインの自動化・省人化を促進する自社ブランド製品開発、製造、販売

省人化に資する製品の開発

予知保全AI
生成マシン



CX-M

マシンビジョン



株式会社ファースト

生産性向上に
貢献

製造業生産部門（生産ライン）に販売



- 設備の予知保全
- 検査の自動化
- 3次元計測
- 外観検査
- 作業の自動化 等

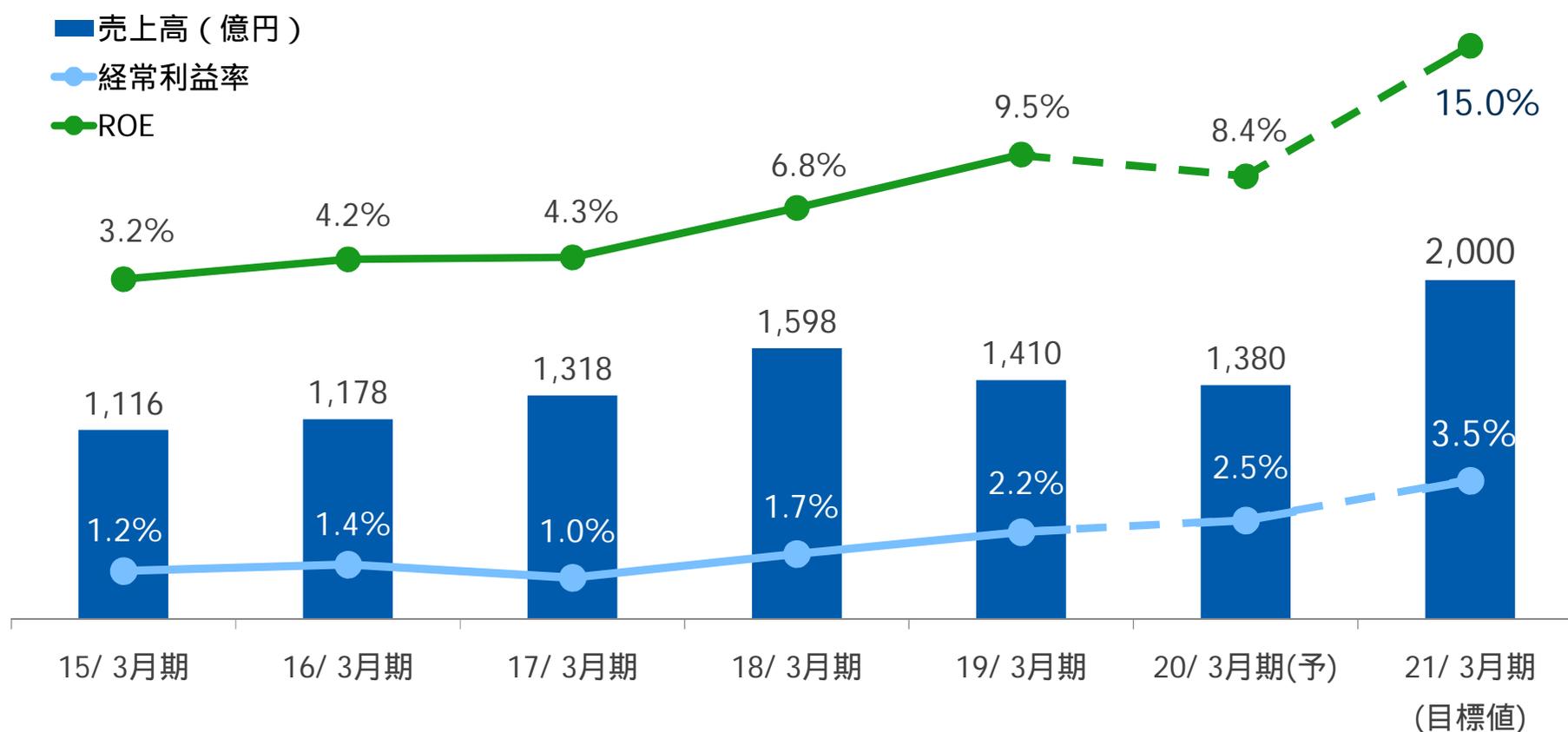


将来の成長に向けた取り組み

中期経営計画 VISION2020



2021年3月期 売上高 2,000億円 経常利益率 3.5%以上 ROE 15.0% を目指す



想定する成長市場

産業機器・ロボット

労働人口減少
ネット通販の増大



車載

運転支援システム
EV/HEVの普及



医療機器

高齢化
高度医療化



クラウドサービス

ITシステム運用の簡易化
FinTech、働き方改革



サーバ・ストレージ

5G・仮想通貨など
ビッグデータ処理



IoT / AI

スマートファクトリー



将来の成長に向けた取り組み



EC事業

システム一括受託開発の推進

PB事業

保有技術を活用した自社ブランド製品開発の強化

CN事業

新製品の導入・技術サービス体制の確立

3事業共通プロジェクト

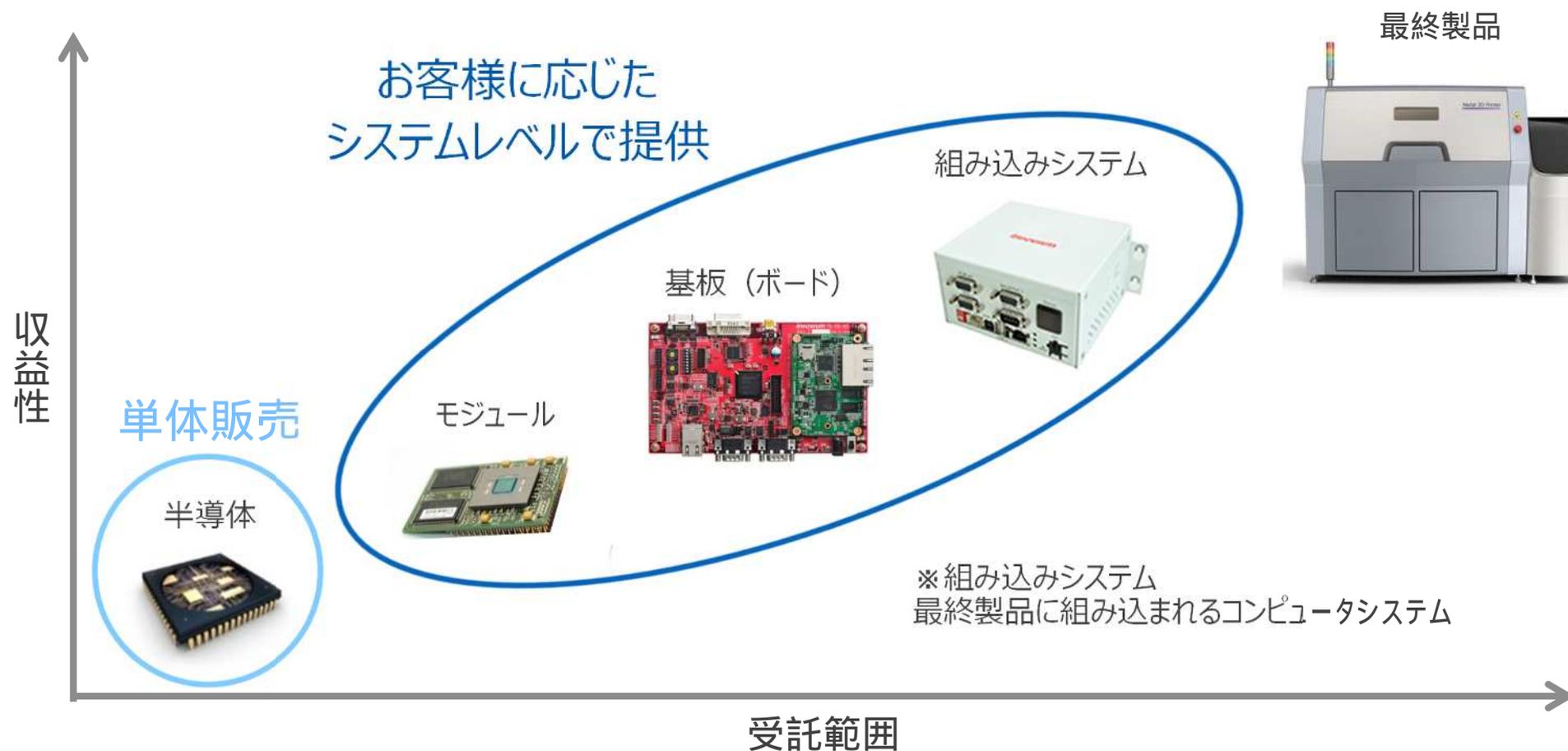
TED REAL IoT

産業分野のIoTビジネス加速化

EC事業 システム一括受託開発の推進



半導体単体から顧客仕様システムまで幅広い提供形態に対応



EC事業 システム一括受託開発の推進



理化学研究所 創薬専用スーパーコンピュータ「MDGRAPE-4A」の開発に参加



PB事業 保有技術を活用した自社ブランド製品開発の強化



3Dビジョンロボットシステム「TriMath」



2019年10月発売

ロボット

画像処理技術

システム構築

周辺機器

ロボットシステムで
提供

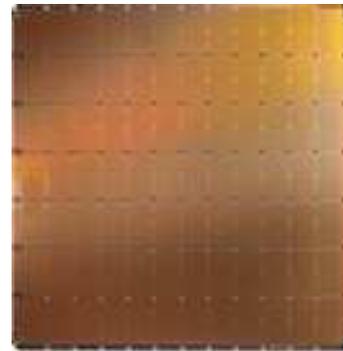
用途

- 重量物のピッキング
- ばら積みの荷物の
積み下ろし など

CN事業 新製品の導入・技術サービス体制の確立



超高速ディープラーニングシステムの取り扱いを開始



「CS-1」に搭載されている
21.5cm角の大型半導体「WSE」

- インターネットサービス、製薬、自動車、学術分野でAI活用の期待が高まる
- ディープラーニングの学習時間を大幅に短縮

セレブラスシステムズ社
超高速ディープラーニングシステム「CS-1」
2019年12月19日受注開始

TED REAL IoT 産業分野のIoTビジネス加速化



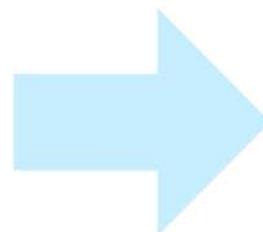
Microsoft Azure (クラウドサービス) を
核とした顧客基盤の拡大



Microsoft
Azure顧客
402社

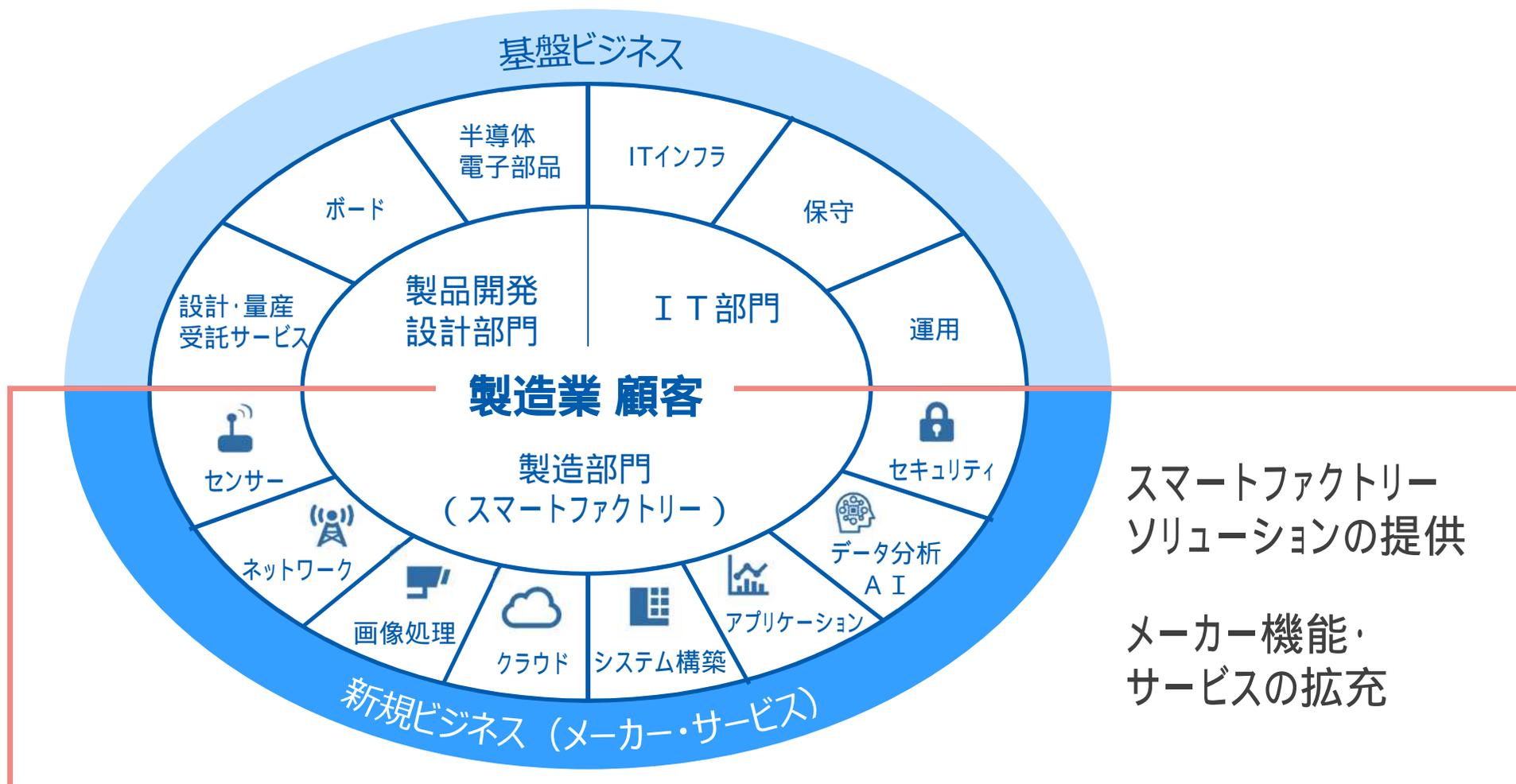
エコシステム
パートナー
140社

※エコシステムパートナー
Microsoft Azure クラウドサービスに
各社のIoT関連技術やサービスを組み合わせて提供



目指す将来像

DRIVING DIGITAL TRANSFORMATION



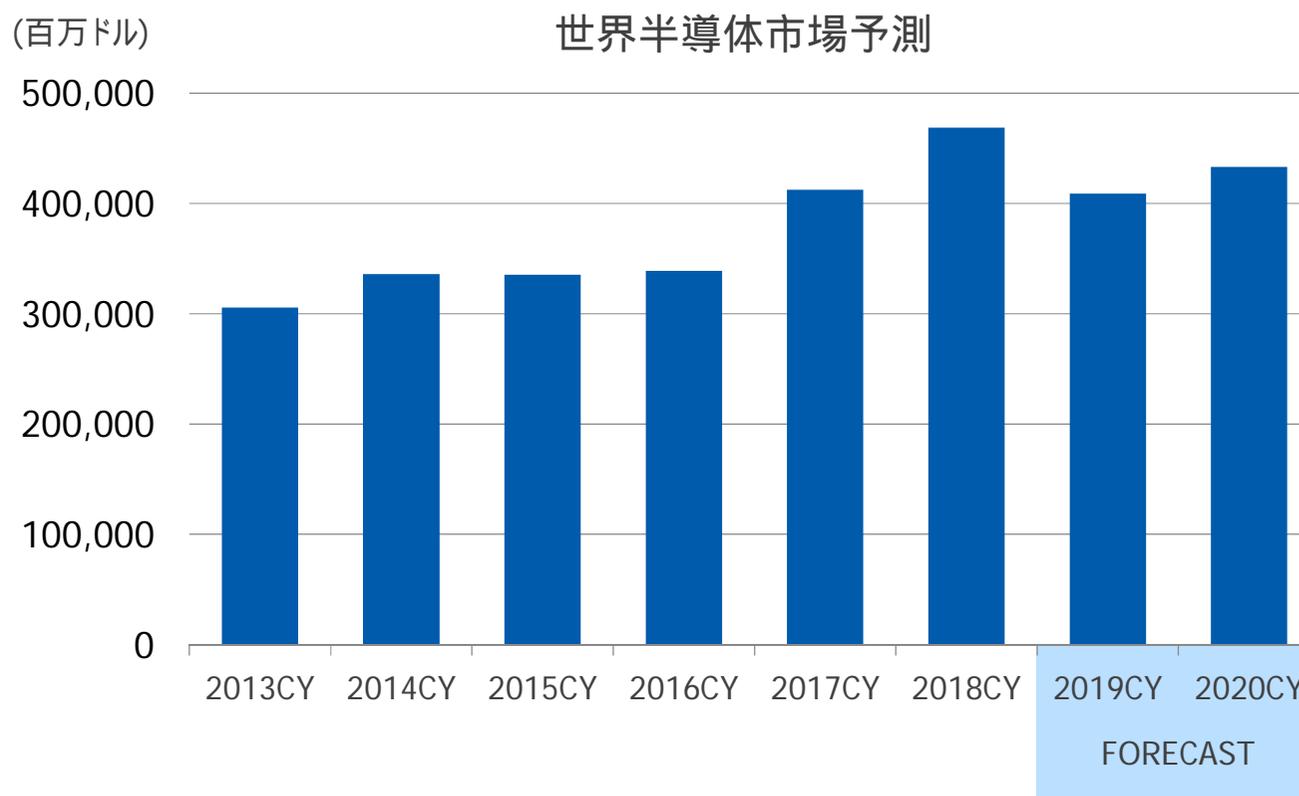


今期業績見通し 配当政策 株価

WSTS 2019年秋季半導体市場予測



- 2019年世界半導体市場は前年比 12.8%と二桁のマイナス成長を予測
- 2020年は5Gの立ち上がりやデータセンタ関連投資の回復などに期待し、前年比+5.9%とプラス成長に回帰すると予測



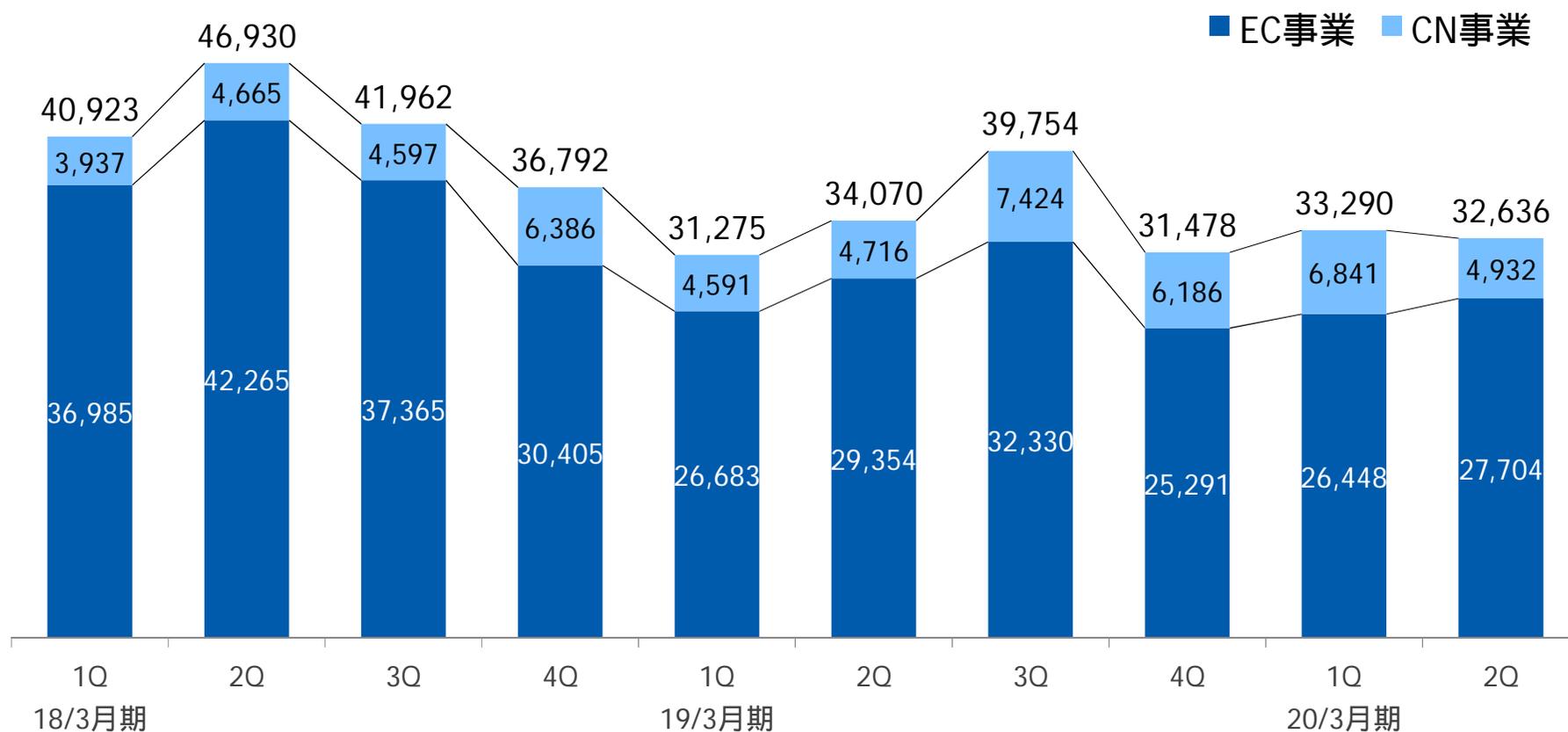
出展：WSTS

受注高の推移



- EC事業 2019年3月期4Qをボトムに底入れの兆し
- CN事業 企業のIT投資需要の拡大を背景に受注好調

(百万円)



18/3月期 2QよりTED長崎の受注高を含む
19/3月期 2Qよりファーストの受注高を含む

2020年3月期 事業環境と業績予想の前提条件



EC事業

- 半導体市場は一部に回復の兆しあるが 今期中は足踏み状態
- 景気減速の影響受けるが 下期は底堅く推移
- 顧客移管（新規顧客の取り込み）は当初想定より遅れ 来期本格化
- PB事業は子会社を含め堅調に成長

CN事業

- 企業・官公庁のIT投資は 生産性の向上への取り組みを背景に堅調
- 製品販売、保守ビジネスともに好調
- 公共教育機関向けビジネスは伸長

今期業績見通し



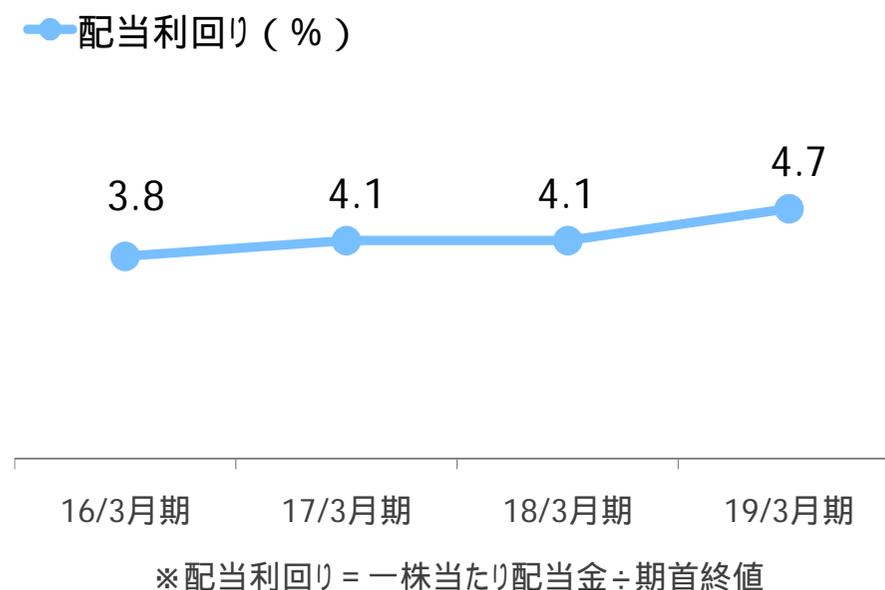
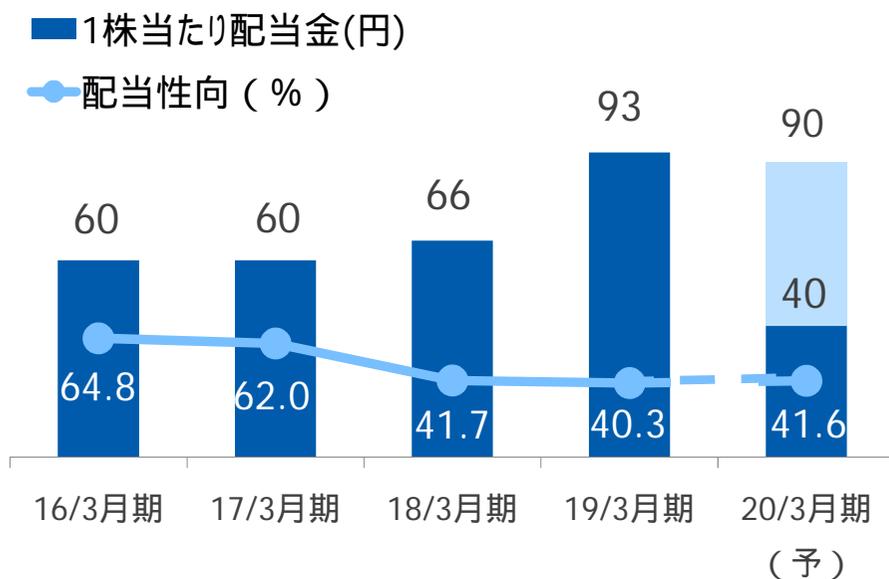
(百万円)

	2019年 3月期	2020年 3月期	対前年比		2020年 3月期	
	通期	通期予想	増減額	増減率	上期実績	通期予想 進捗率
売上高	141,000	138,000	3,000	2.1%	65,213	47.3%
EC事業	119,660	113,500	6,160	5.1%	54,282	47.8%
CN事業	21,340	24,500	3,159	14.8%	10,930	44.6%
経常利益 (利益率)	3,077 (2.2%)	3,500 (2.5%)	422	13.7%	1,340	38.3%
当期純利益 (利益率)	2,341 (1.7%)	2,200 (1.6%)	141	6.0%	864	39.3%

当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益

配当政策と配当予想

- 連結配当性向は40%を目安
- 安定的 継続的な配当を実施



株価推移



証券コード	2760
12月16日株価	2,596円
最低購入金額	259,600円
PER (予想) (株価収益率)	12.03倍
PBR (株価純資産倍率)	1.01倍
配当利回り (予想)	3.47%



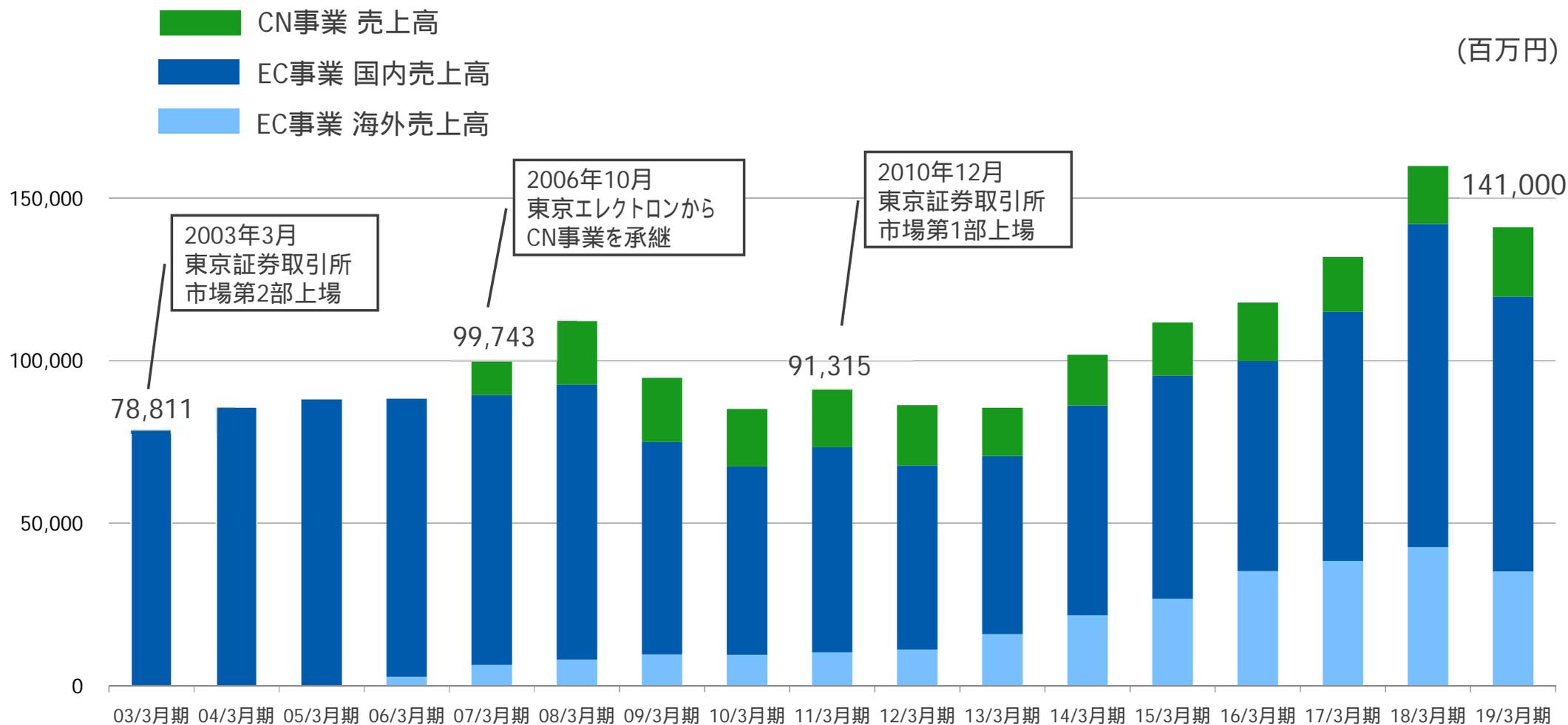
ご清聴ありがとうございました

参考資料：当社のあゆみ



- 1965年 東京エレクトロン株式会社で電子部品ビジネスを開始
- 1998年 東京エレクトロン株式会社から 電子部品事業
(現：半導体及び電子デバイス事業) を全て譲受け
- 2003年 東京証券取引所 市場第2部上場
- 2006年 東京エレクトロン株式会社から コンピュータネットワーク事業
(現：コンピュータシステム関連事業) を承継
- 2010年 東京証券取引所 市場第1部上場
- 2017年 株式会社アバール長崎 (現：東京エレクトロン デバイス長崎株式会社) を
連結子会社化
- 2018年 株式会社ファーストを連結子会社化

参考資料：連結業績推移



参考資料：連結損益計算書



(百万円)

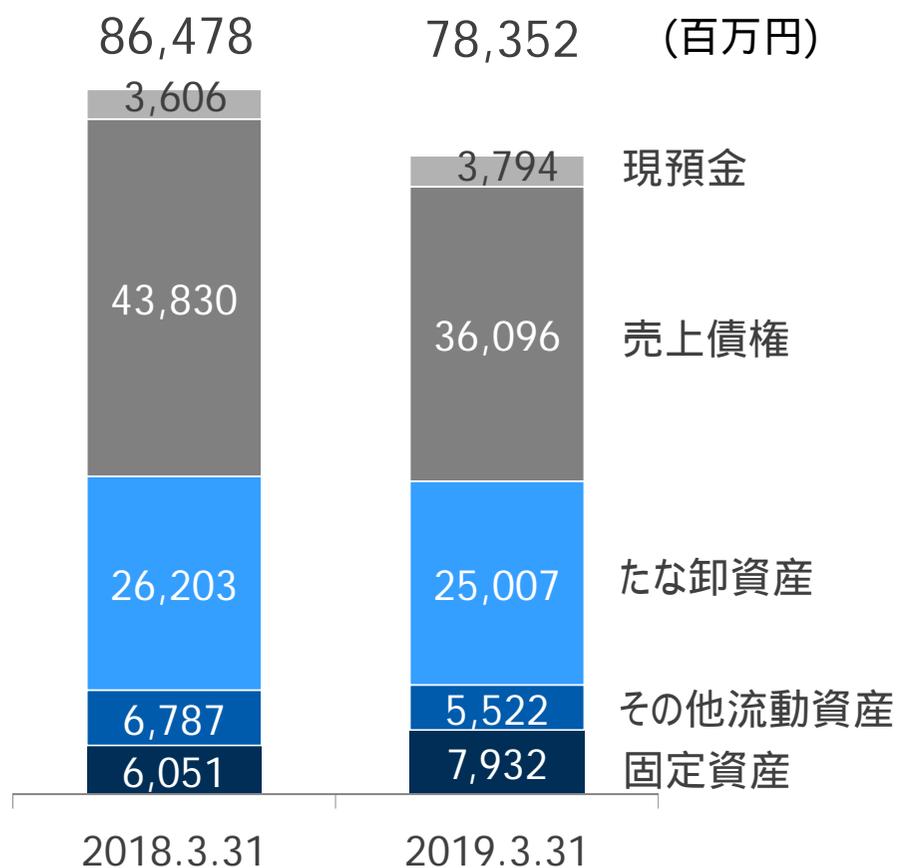
	2018年3月期	2019年3月期	対前年比	
			増減額	増減率
売上高	159,841	141,000	18,840	11.8%
売上総利益	17,680 (11.1%)	19,705 (14.0%)	2,024	11.5%
営業利益	2,755 (1.7%)	3,525 (2.5%)	769	27.9%
経常利益	2,637 (1.7%)	3,077 (2.2%)	439	16.7%
当期純利益	1,598 (1.0%)	2,341 (1.7%)	742	46.5%
1株当たり当期純利益	158円22銭	230円65銭		
従業員数	1,066名	1,210名		

()内は利益率
 当期純利益は
 親会社株主に帰属する当期純利益

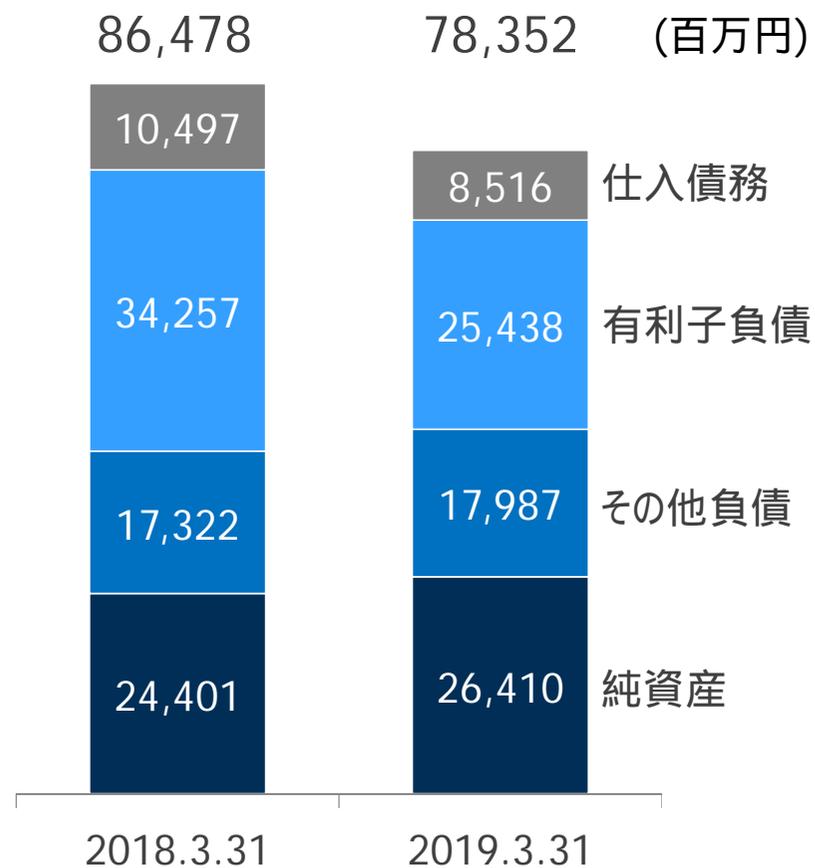
参考資料：連結貸借対照表



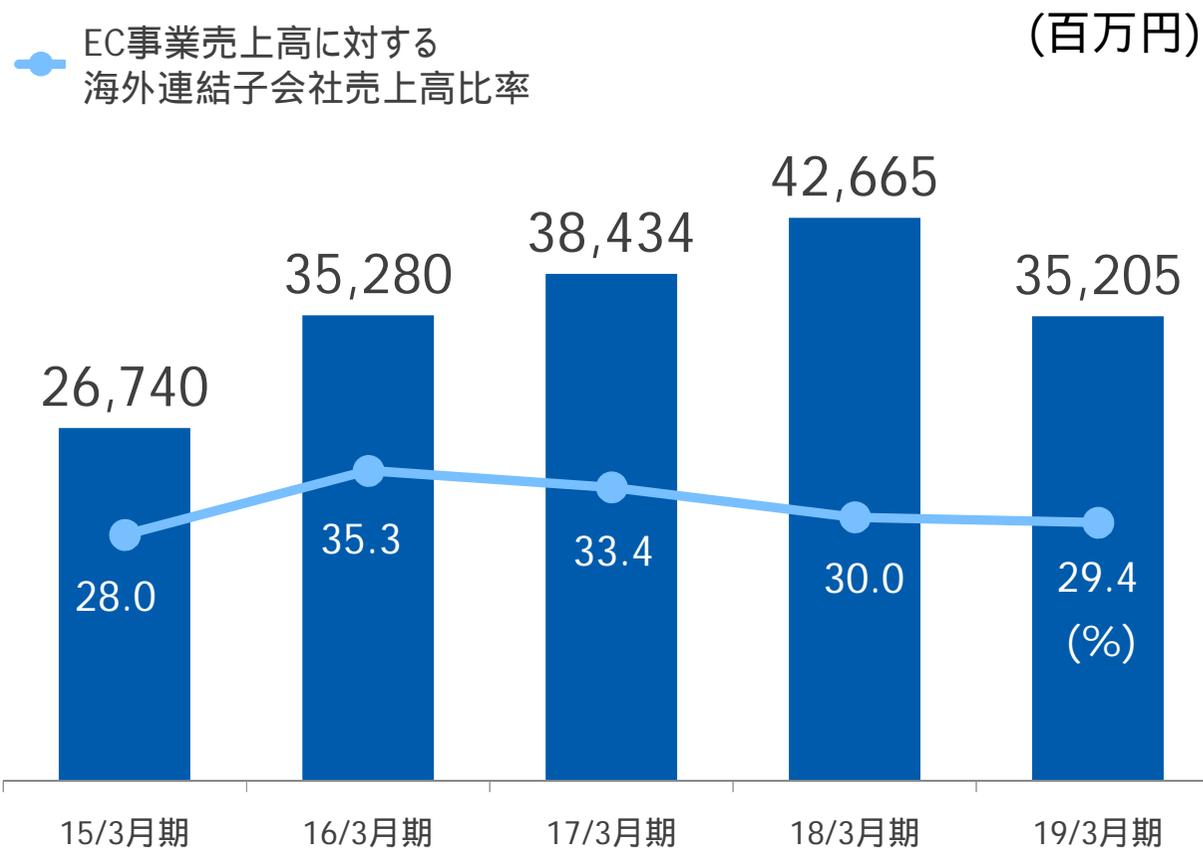
資産



負債・純資産



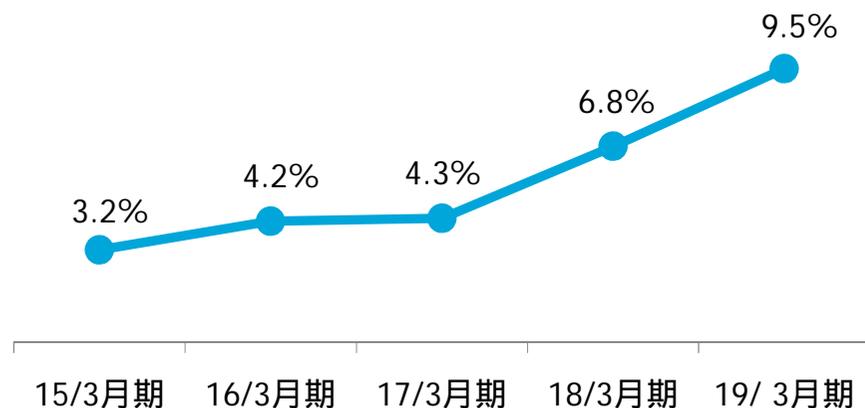
参考資料：海外連結子会社 売上高推移



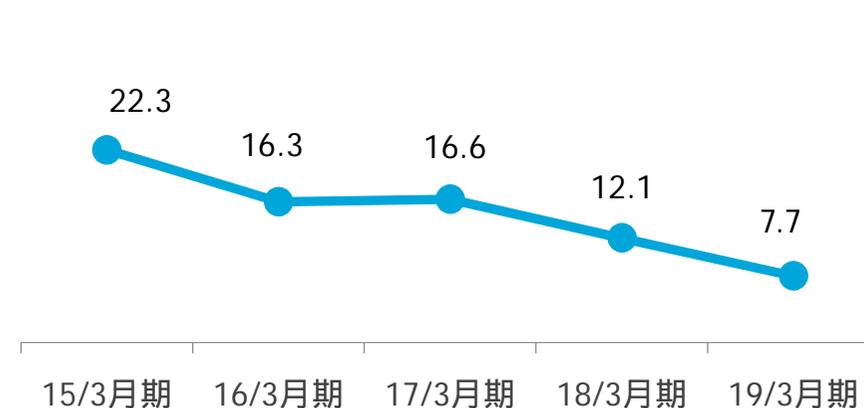
参考資料：経営指標



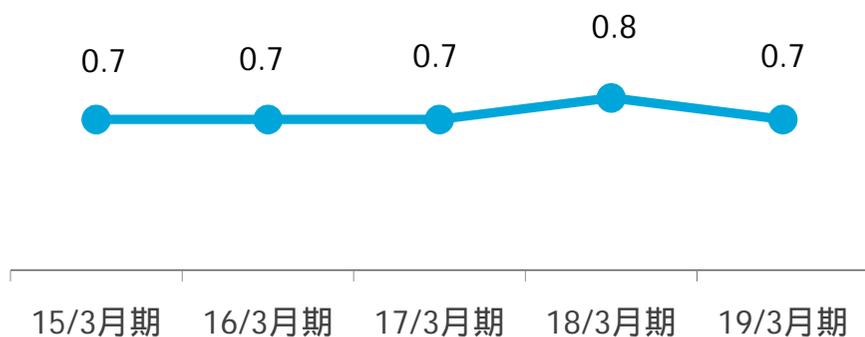
株主資本当期純利益率 ROE (%)



株価収益率 PER (倍)

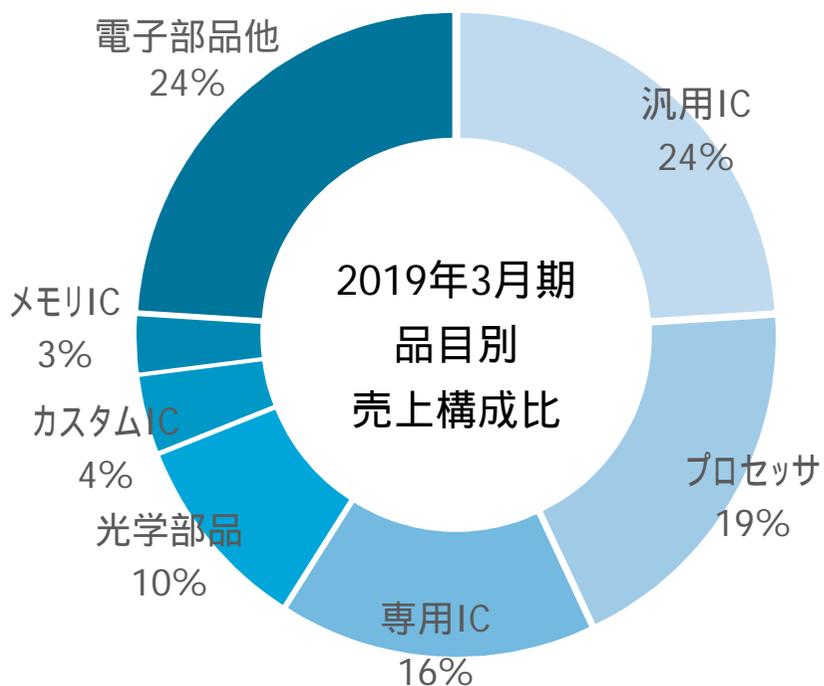


株価純資産倍率 PBR (倍)



- ※株主資本当期純利益率 (ROE) = $\frac{\text{親会社株主に帰属する当期純利益}}{\text{期首・期末平均株主資本}}$
- ※株価収益率 (PER) = $\frac{\text{期末株価}}{\text{一株当たり当期純利益}}$
- ※株価純資産倍率 (PBR) = $\frac{\text{期末株価}}{\text{一株当たり純資産}}$

参考資料：EC事業 仕入先



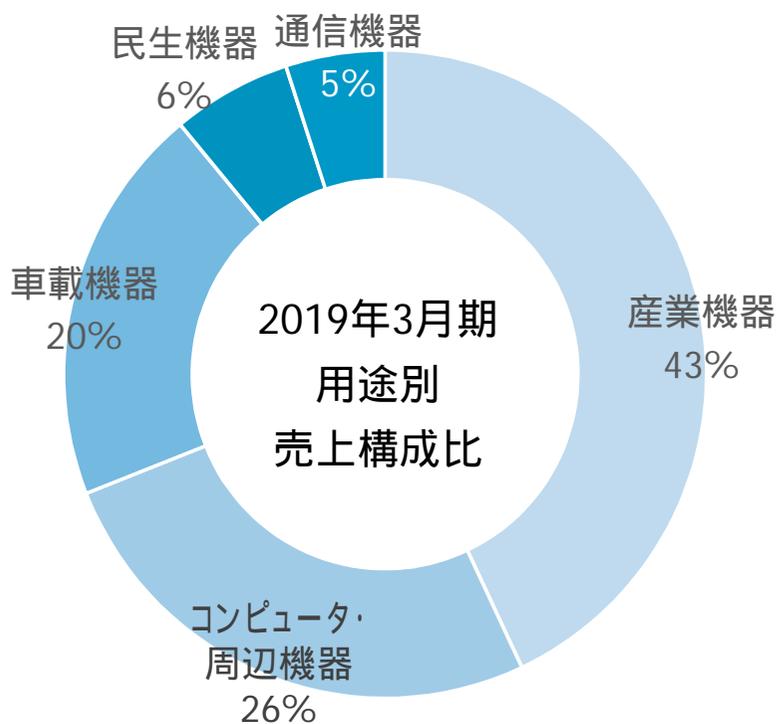
品目	主な商品
汎用IC	アナログIC、ロジックIC
プロセッサ	マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ
専用IC	通信・ネットワーク、画像処理、セキュリティ、周辺制御
光学部品	LED、フォトカプラ、光ファイバ、IrDA
カスタムIC	ASIC、PLD (FPGA / CPLD)
メモリIC	フラッシュメモリ、SRAM / FRAM / MRAM
電子部品他	各種ボード / 電源コネクタ、ソフトウェア等



Intel

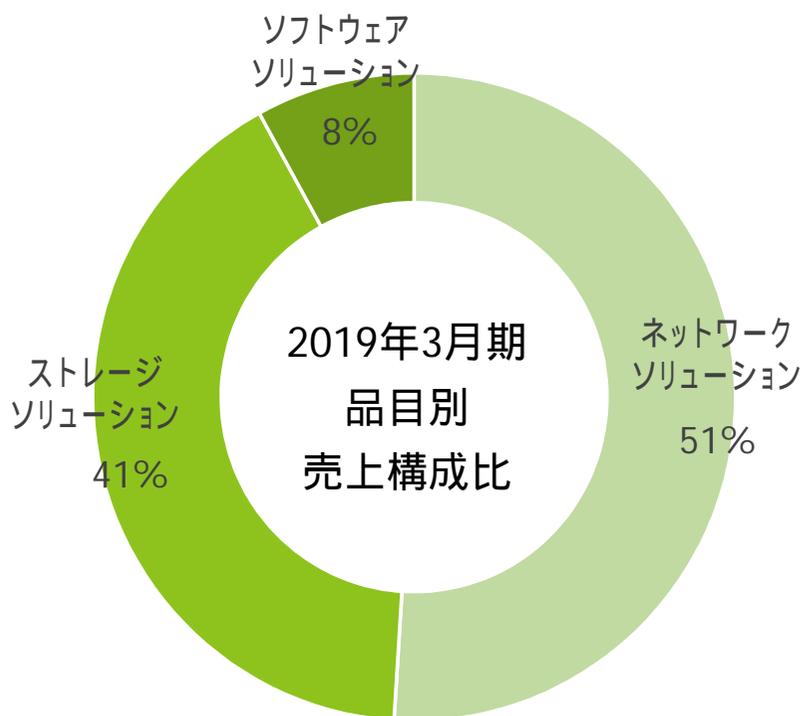


参考資料：EC事業 販売先



用途	主な商品	
産業機器	医療機器、FA機器、計測器 放送機器、ロボット	
コンピュータ・周辺機器	複合プリンター（MFP/LBP/IJP） プロジェクタ、POSシステム、 PC周辺機器	
車載機器	カーナビゲーション、ディスプレイオーディオ カーインフォテインメント	
民生機器	薄型TV、AV機器 デジタルカメラ	
通信機器	携帯電話/スマートフォン 携帯基地局	

参考資料：CN事業 仕入先



ソリューション	主な製品	主な仕入先
ネットワークソリューション 	負荷分散スイッチ 仮想化関連 セキュリティ関連	
ストレージソリューション 	SSDストレージ バックアップストレージ データ圧縮アプライアンス	 
ソフトウェアソリューション 	仮想化インフラ セキュリティ関連	

参考資料：国内エレクトロニクス商社、情報通信関連企業



国内エレクトロニクス商社 【卸売業】

マクニカ・富士エレホールディングス 加賀電子 レスターホールディングス 丸文
トーマンデバイス リョーサン 菱電商事 エレマテック 立花エレテック 伯東
サンワテクノス 三信電気 萩原電気ホールディングス カナデン 新光商事
たけびし 他

情報通信関連企業 【情報通信業】

伊藤忠テクノソリューションズ SCSK ネットワンシステムズ 兼松エレクトロニクス
テクマトリックス 他